



大聯大創新設計大賽-校園推廣規劃

2018.3.12



大聯大控股

大聯大控股是全球第一，亞太區最大的半導體零組件通路商。大聯大兩年一屆的創新設計大賽，為電子相關大專院校學生提供展現潛力的舞台，繼 2014年首屆賽事，今年第三屆以“**智慧芯城市，馳騁芯未來**”為主題，將提供豐富的資源及技術支持，藉由產學交流激發學生創造潛能、團隊協作、創意設計及前瞻性思考能力，期匯集兩岸大專院校的菁英團隊，選拔“智慧城市”及“車聯網”時代的科技新生力量。

大賽主題：智慧城市 & 車聯網

獎金設置



進入決賽的隊伍都將獲得精美禮品一份。所有提交完整作品資料的團隊，都將獲得由大賽主辦方提供的參賽證書。

28片開發板任選

開發板

編號	名稱	特徵
1_W01	世平 NXP MK64 IoT/ 智能家居 MCU 開發板 方案框圖	基於 NXP MK64 的 MCU 評估板，支持乙太網功能，支持 Micro SD，CAN BUS總 WiFi/BT 模塊。可應用於工業網關、充電樁、車聯網，智能家居等應用領域。開發板 120MHz Cortex-M4F MCU, 1MB Flash, 256KB SRAM, Full-Speed USB, Ethernet 檔案下載： 開發板簡介 開發板框圖
1_W02	世平 NXP JN5169 ZigBee Dongle 方案框圖	基於 NXP JN5169 的 ZigBee 模塊，UART1 可作為與外部 MCU 進行通信的接口 外 儲空間充足。配置有 USB UART 轉換晶片，可做為 Dongle 使用。 檔案下載： 開發板簡介 開發板框圖
1_W03	世平 NXP QN9022 BLE 通信模塊 方案框圖	基於 NXP QN9022 的 BLE 模塊小板，支持主模式和從模式，在主模式最多可同時 應用於各種藍牙應用。 檔案下載： 開發板簡介 開發板框圖
1_W04	世平 NXP JN5169 ZigBee 無線收發模組 方案框圖	JN5169 模組，在 ZigBee 協議的基礎上實現無線收發，兼容 2.4 GHz IEEE802.15.4, 開關、溫濕度傳感器，路燈，插座等產品中。 檔案下載： 開發板簡介 開發板框圖
1_W05	世平 NXP QN9080+SPRD SC6531E 多功能 共享單車鎖 方案框圖	本開發板支持 NFC、BLE、GPRS/NB-IoT 通訊，支持定位功能，GPS 監測/GPRS 上 G-sensor 監測功能。可將此開發板應用於共享單車，車輛定位監控等車聯網應用中。 檔案下載： 開發板簡介 開發板框圖
1_W06	世平 NXP i.MX6UL 城市網關開發板 方案框圖	i.MX6UL 最小系統，核心板排針設計，集成 DDR3 SLC-NANAFSLASH/SLC-Emmc PMIC。集成 USB，串口，網口，多路 IIC，SPI，IIS，LCD 以及 PCIe 高速接口，： 關，機器人等應用的開發設計。開發板基本規格：單核 Cortex-A7，最高主頻 696MHz 檔案下載： 開發板簡介 開發板框圖
1_W07	世平 Telink TLSR8267 MCU 開發板 方案框圖	Telink USB dongle，是一個易於設計的BLE開發平台，評估和測試BLE項目。其功能 接口，Core MCU描述，網絡功能以及透過主機驅動程序。包含了BLE / 2.4G射頻基

主要分類

- 智能家居
- IoT(可用於AWS)
- 車聯網
- 機器人
- 通訊模組
- 定位系統

時辰表

重要時程：

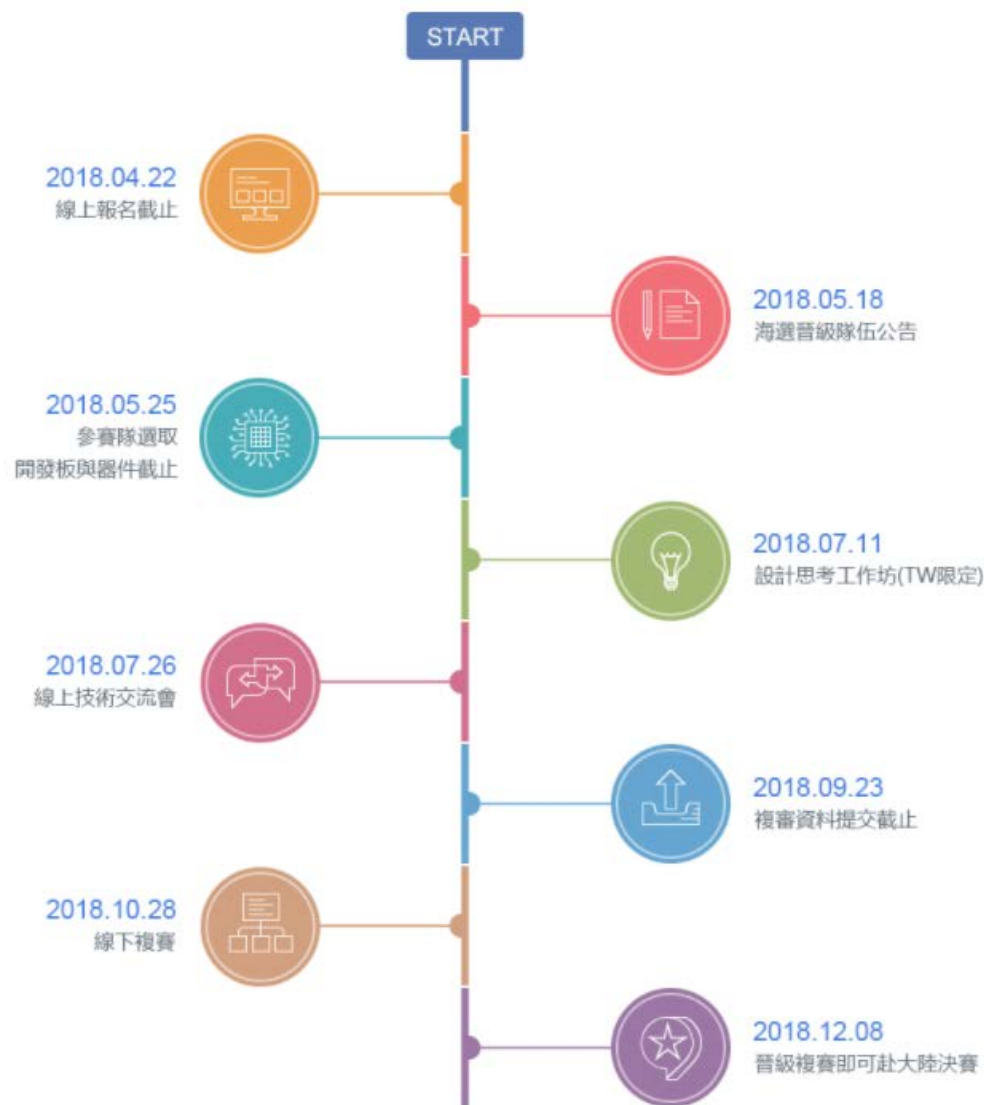
04/22 報名截止 (含繳件)

07/11 設計思考工作坊

09/23 複賽繳件截止

10/28 線下複賽

12/08 決賽(北京)





比賽特點

■ 開發板 / 器件贊助 + 製板費：

通過海選後，參賽團隊除了可得到免費的開發板及器件申請，大聯大還提供成品製作補貼，每隊費用上限約合台幣10K實報實銷

■ 研華設計總監工作坊：

由研華設計總監(在TIC100協助同學做產品發想)擔任講師,以實作方式帶同學如何從使用者角度結合開發板應用做作品設計,突破以技術出發的框架

■ 受邀大陸決賽：

CN機票&住宿全包式贊助(RMB 5K/人*每隊3人*5隊, 實報實銷)

■ 決賽獎狀&獎金：

前10名可獲約合台幣13K~150K獎金不等

參賽條件

- 具有大專院校學生身份(不限在職, 碩士, 博士)
- 參賽人數1~6人/組
- 需指導老師
- 初賽計畫書下載連結：<https://goo.gl/B5de8D>
- 大賽網站連結：<https://goo.gl/Z9DYNK>

活動海報



第三屆大聯大 創新設計大賽

智慧芯城市 馳聘芯未來

即日起 - 4/22 線上報名截止

大賽報名請洽

聯繫窗口
☎ 02-2579-2793 / 0958-277-581
✉ competition@istunet.com
詳細資訊請參考官方網站
<http://i-design.wpgholdings.com>



大賽簡介

大聯大控股是全球第一，亞太區最大的半導體零組件通路商。大聯大兩年一屆的創新設計大賽，為電子相關大專院校學生提供展現潛力的舞台。繼2014年首屆賽事，今年第三屆以「智慧芯城市，馳聘芯未來」為主題，將提供豐富的資源及技術支持，藉由產學交流激發學生創造潛能、團隊協作、創意設計及前瞻性思考能力，期匯集兩岸大專院校的菁英團隊，選拔「智慧城市」及「車聯網」時代的科技新生力量。

獎項說明

冠軍*1: NTD 15萬元
亞軍*1: NTD 10萬元
季軍*1: NTD 5萬元
佳作*6: NTD 1萬元
最具未來性獎*1: NTD 1萬元

大賽流程

線上報名截止	海選晉級隊伍公告	設計思考工作坊 (TW限定)	線上技術交流會	線下複賽	晉級複賽即可赴大陸決賽
04/22	05/18	07/11	07/26	10/28	12/08

* 大賽相關重要日程依大賽官網公佈為準

主辦單位:  大聯大控股 WPG Holdings

白金級贊助商: 

黃金級贊助商:  



Thank you

產業首選 · 通路標竿